

Praktische Anwendung einer elektrischen und thermischen Simulation einer Platine zur Ansteuerung einer Leistungselektronik

Christian Schmid

Hochschule Augsburg, Fakultät für Elektrotechnik, Augsburg, Deutschland, Christian.Schmid1@Hs-Augsburg.de

Zusammenfassung

Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand. Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand. Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand. Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand. Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand. Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand. Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand. Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand. Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand.

Abstract

Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand. Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand. Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand. Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand. Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand. Dies ist ein normaler Text in 10 pt Schriftgröße und 12 pt Zeilenabstand.

1 Grundlagen

1.1 Wärmefluss

Es gibt 3 Möglichkeiten wie sich Wärme ausbreiten kann. Durch Strahlung, Konvektion und Konduktion [1]. Alle 3 Ausbreitungsmöglichkeiten treten an der Platine auf, siehe Abbildung 1.

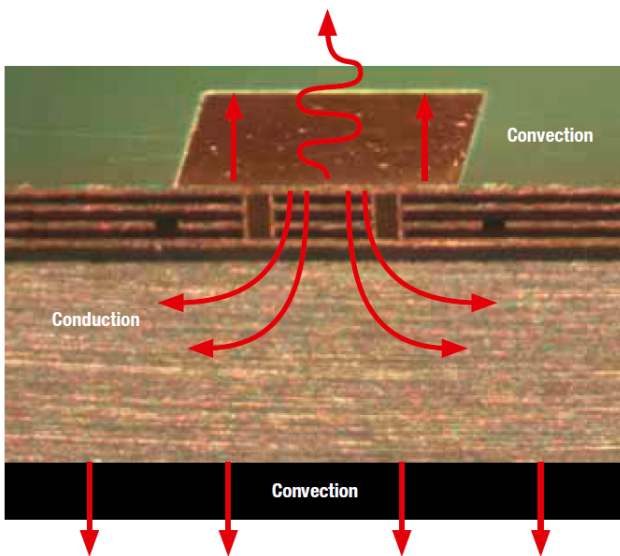


Abbildung 1: Wärmefluss auf einer Platine, [1]

1.2 Thermische Auslegung

Elektrische Komponenten haben einen Betriebstemperaturbereich. Bauteile werden vom Hersteller im Temperaturbereich getestet. Aus den Messdaten wird der zu erwartende Lebenszyklus ermittelt. Bei Überschreiten der Temperatur kann die Lebenszeit der Bauteile rapide abnehmen. Besonders gefährdet sind Elektrolyt Kondensatoren. Meist beträgt die maximale Temperatur 105°C. Bei Erhöhung der Betriebstemperatur um jeweils 10K

halbiert sich die Lebensdauer der Bauteile [3].

Um die Verluste und daraus entstehende Abwärme durch Selbstinduktion und elektrische Widerstände auf der Leiterbahn gering zu halten, wird die Leiterbahn abhängig von der Anwendung unterschiedlich ausgelegt.

Eine Versorgungsleitung benötigt eine größere Leiterbahnfläche als eine Messleitung, da die Versorgungsleitung einen höheren Strom führt. Der Strom geht quadratisch in die Leistungsformel ein, siehe Formel 1.

$$P_{\text{elektrisch}} = P_{\text{thermisch}} = I^2 \cdot R_{\text{Leiter}} \quad (1)$$

1.3 Leistungselektronik

In der Leistungselektronik wird getaktet an- und abgeschaltet. Die Schaltfrequenz ist 100 - 10.000 so groß wie die gewollte Funktion. Die Schaltfrequenz ist zu groß für das System. Dies wird bei der Ansteuerung von Motoren verwendet, vgl. Abbildung 2)

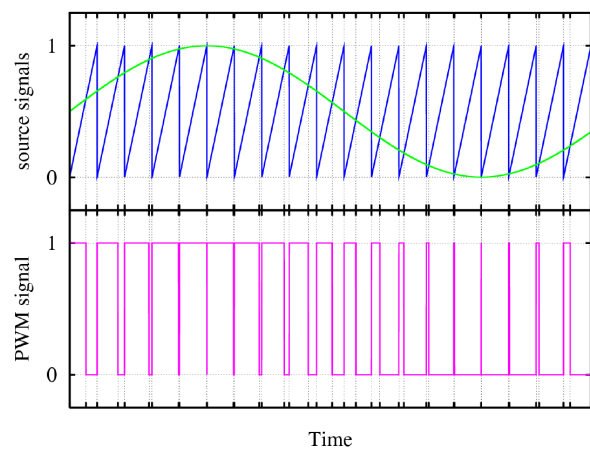


Abbildung 2: Aussteuerung einer Phase eines Motors, [2]

Da sich der eingestellte Strom sehr schnell verändert und das System sich nur langsamer ändert kann davon ausgegangen werden, dass in den Leitungen ein konstanter Strom fließt.

2 Thermisches Design

Industriestandards geben Leiterbahnbreiten abhängig von Strombelastungen an [5].

2.1 Platinenaufbau

Der Aufbau einer 2 lagigen Platine ist in Abbildung 3 dargestellt.

Die mittlere Schicht der Platine besteht aus FR4, einem 1,5mm breiten Dielektrikum [6]. Die Leiterbahnhöhe auf Ober- und Unterseite betragen jeweils 35µm [7].

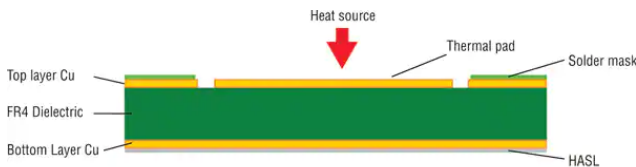


Abbildung 3: Querschnitt einer Platine [6]

Mittels Vias kann die Wärmeenergie einfacher durch die Platine fließen. Dieser Fall wird nicht untersucht.

2.2 Überprüfung des Vorgabewerts

Die Arbeit widmet sich der Bestimmung des Thermischen Widerstands und der Platinenerwärmung durch den eingestellten Strom.

Für einen Strom von $I_{Strang} = 5A$ und einer maximalen Erwärmung von 10K ergibt sich nach dem Industriestandard eine Leiterbahnbreite von $b = 4mm$ [5].

Für die Arbeit wird ein Strom von $I_{Strang} = 5A$ und eine Leiterbahnbreite von $b = 4mm$ untersucht. Die Platine hat die Maße 15mmx15mm. Die Abmaße der zu simulierende Platine sind in Abbildung 4 ersichtlich.

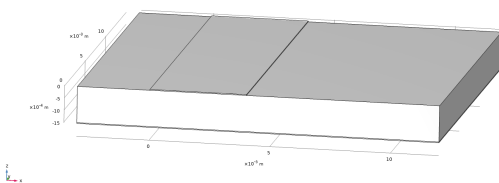


Abbildung 4: Geometrie der verwendeten Platine

3 Händische Rechnung

3.1 Vorbedingungen

Der Wärmestrom wird durch den elektrischen Strom der Leiterbahn und den Widerstand des Leiters bestimmt.

Die elektrische Leitfähigkeit von Kupfer beträgt

$$\rho_{Cu} = \frac{58.1 \cdot 10^6}{Sm^{-1}}.$$

Die zu simulierende Leiterbahnlänge beträgt

$$l = 15mm.$$

Die Querschnittsfläche der Leiterbahn beträgt:

$$A = b \cdot h = 4mm \cdot 35\mu m = 140m^{-9} \quad (2)$$

Der Widerstand der Leiterbahn beträgt:

$$R_{Leiter} = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{l}{A} = 1,84 \cdot 10^{-3} \Omega \quad (3)$$

Der elektrische Schaltplan ist in Abbildung 5 ersichtlich.

Es stellt sich eine Spannung über dem Widerstand ein, vgl. Formel 4.

$$U_{Verlust} = I_{Strang} \cdot R_{Leiter} \quad (4)$$

Die Verlustspannung beträgt $U_{Verlust} = 5A \cdot 1,84 \cdot 10^{-3} \Omega = 9.2mV$. Die elektrische Verlustleistung wird mit Formel 1 berechnet: Es wird $P_{Thermisch} = (5A)^2 \cdot 1,84 \cdot 10^{-3} \Omega = 46 \cdot 10^{-3} W$ in das System eingepreßt. Die Erwärmung wird mit Formel 5 berechnet.

$$\Delta T = P_{Thermisch} \cdot \Theta_{Junction,Ambient} \quad (5)$$

3.2 Berechnung

Die Berechnung der Erwärmung erfolgt mit dem thermischen Widerständen Θ , vgl. Formel 6.

$$\Theta_{Junction,Ambient} = \frac{1}{h} \quad (6)$$

Der Wärme-Transfer-Koeffizient zwischen Platine und Umgebung wird mit $h = 10 \frac{W}{m^2 K}$ angenommen [4].

Der thermische Widerstand $\Theta_{Junction,Ambient}$ wird mittels Formel 7 berechnet.

Für den Wärmestrom wird die gesamte Oberfläche der Platine verwendet. Die Fläche der Oberseite und der Unterseite der Platine betragen:

$$A = 2 \cdot 15mm \cdot 15mm.$$

$$\Theta_{Junction,Ambient} = \frac{\frac{1}{10 \frac{W}{m^2 K}}}{2 \cdot 15mm \cdot 15mm} = 222 \frac{K}{W} \quad (7)$$

Die Platine erwärmt sich nach der Formel 5 um

$$\Delta T = 46 \cdot 10^{-3} W \cdot 222 \frac{K}{W} = 10.2K.$$

3.3 Elektrischer Schaltplan für den Wärmestrom

Um den Wert genauer zu bestimmen wird ein Ersatzschaltbild erstellt. Es werden die thermischen Widerstände berechnet. Das Ersatzschaltbild wird ohne thermische Kapazitäten dargestellt, da uns der statische Zustand interessiert, nicht der transiente. Um das System noch von Hand zu simulieren, wird angenommen, dass der Wärmestrom nur nach oben und nach unten fließt. Der thermische Widerstand wird durch Formel 8 berechnet.

$$\Theta = \frac{höhe}{A \cdot \lambda} \quad (8)$$

Die thermische Leitfähigkeit von Kupfer beträgt:

$$\lambda_{Cu} = 360 \frac{W}{mK} [1]$$

Für den spezifischen Fall beträgt der thermische Widerstand von der Leiterbahn:

$$\Theta_{Leiterbahn} = \frac{35\mu m}{4mm \cdot 15mm \cdot 360 \frac{W}{mK}} = 1,62 \cdot 10^{-3} \frac{K}{W}$$

Die thermische Leitfähigkeit von FR4 beträgt:

$$\lambda_{FR4} = 0,3 \frac{W}{mK} [1]$$

Für den spezifischen Fall beträgt der thermische Widerstand von dem Dielektrikum:

$$\Theta_{FR4} = \frac{1,5mm}{4mm \cdot 15mm \cdot 0,3 \frac{W}{m \cdot K}} = 1,62 \cdot 10^{-3} \frac{K}{W}$$

Der thermische Widerstand zwischen Leiterbahn und Ambient beträgt:

$$\Theta_{Leiterbahn, Ambient} = \frac{\frac{1}{10 \frac{W}{m^2 \cdot K}}}{2 \cdot 15mm \cdot 15mm - 4mm \cdot 15mm} = 256 \frac{K}{W}$$

Der thermische Widerstand zwischen Platine ohne Leiterbahn und Ambient beträgt:

$$\Theta_{PCB, Ambient} = \frac{\frac{1}{10 \frac{W}{m^2 \cdot K}}}{4mm \cdot 15mm} = 1666 \frac{K}{W}$$

Es wird eine Parallelschaltung entwickelt.

Ein Teil des Wärmestroms fließt über die Leiterbahn direkt an die Umgebung.

Ein anderer Teil fließt senkrecht durch die Platine und gibt dort die Wärmeenergie ab. Der Schaltplan ist in Abbildung 5 dargestellt.

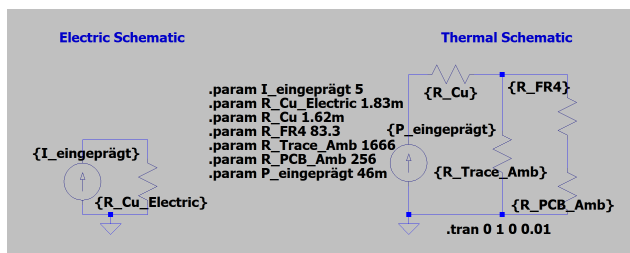


Abbildung 5: Schaltplan: Elektrischer Stromkreis (links)
Schaltplan: Statische Temperatur (rechts)

Die Leistung in Abbildung 5 stellt die Stromquelle dar. Die Spannung ist die Temperaturerhöhung zur Referenztemperatur. Die Widerstände sind die thermischen Widerstände zwischen den Elementen.

Die Platine erwärmt sich um knapp $\Delta T = 13K$

4 Simulation

4.1 Allgemein

An einem Ende wird Strom eingeprägt. Am anderen Ende ist Masse. Die Geometrie ist in Abbildung 4 ersichtlich. Mit Formel 9 berechnet das Simulationsprogramm die abgegebene Energie an die Umwelt.

$$-n \cdot q = \epsilon \sigma (T_{amb}^4 - T^4) \quad (9)$$

Mit Formel 10 und 11 berechnet das Simulationsprogramm das Zusammenspiel der Elektrotechnik und der Thermodynamik.

$$\rho c_p u \cdot \nabla = \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + Q_e \quad (10)$$

$$Q_e = J \cdot E \quad (11)$$

4.2 Netz

Die Vernetzung ist in Abbildung 6 dargestellt. Die Breiten der beiden Geometrien unterscheiden sich deutlich. Ein Abmaß beträgt $15mm$. Das andere Abmaß ist $35\mu m$. Wird das Netz gröber als normal eingestellt werden folgende Warnungen erzeugt:

Edge is much shorter than the specified minimum element size.

Face is (or has a narrow region that is) much smaller than the specified minimum element size.

Domain has a region that is much thinner than the specified minimum element size.

Das Netz muss genauer eingestellt werden damit dieser Fehler nicht mehr auftritt.

Es kann nur eine endliche Fläche untersucht werden. Die Simulationszeiten werden groß beilange und großen Flächen.

Abhängig von der Netzauswahl ergibt sich kein Unterschied bei den berechneten Spannung und der Temperatur. Die Netzunabhängigkeit wurde überprüft.

Unabhängig ob Warnungen beim Vernetzen auftreten oder nicht unterscheiden sich die Ergebnisse nicht.

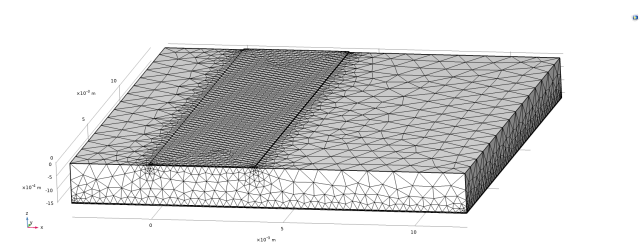


Abbildung 6: Vernetzung des Modells

4.3 Spannungsverlauf

Die Spannung verläuft linear über die Leiterbahn. Das stimmt mit dem erwartenden Ergebnis überein. Die maximale Spannung beträgt $U_{Verlust} = 9,22mV$, vgl. Abbildung 7

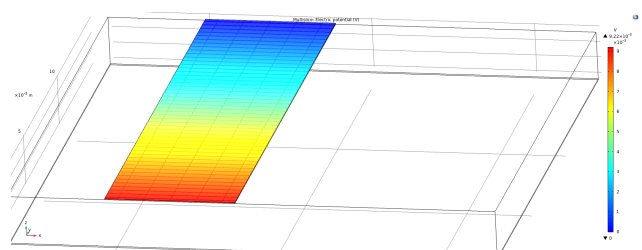


Abbildung 7: Spannungsabfall über der Leiterbahn

4.4 Statischer Temperaturverlauf

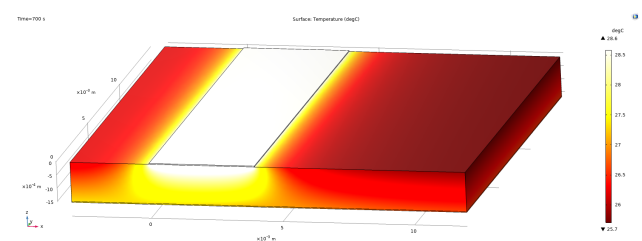


Abbildung 8: Thermische Endzustände

Die Temperatur erhöht sich in der Simulation in der Mitte der Leiterbahn um $8,6K$. Kupfer ist ein sehr guter Wärmeleiter. Er hat einen sehr geringer Widerstand. Am Rand der Leiterbahn ist die Temperatur immernoch

nahezu identisch. Die Wärme verteilt sich sehr gut. Das Dielektrikum hingegen hat einen großen thermischen Widerstand. Die Unterseite der Platine ist bereits 1,5K kälter., vgl. Abbildung 8.

Bereits wenige Millimeter daneben ist die Temperatur deutlich niedriger, vgl. Abbildung 9. 8mm neben der Leiterbahn steigt die Oberflächentemperatur um 5,6K

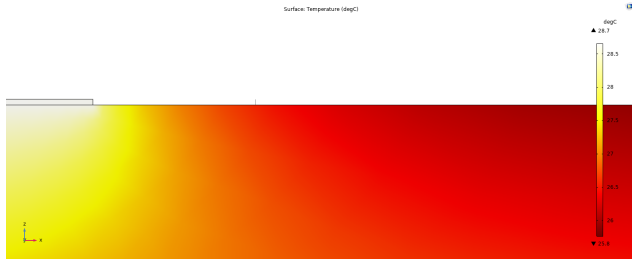


Abbildung 9: Detailansicht Wärmefluss auf der Platine

4.5 Transienter Temperaturverlauf

In Abbildung 10 ist der transiente Verlauf für einen Punkt im Mittelpunkt der Leiterbahn 8mm neben der Leiterbahn dargestellt.

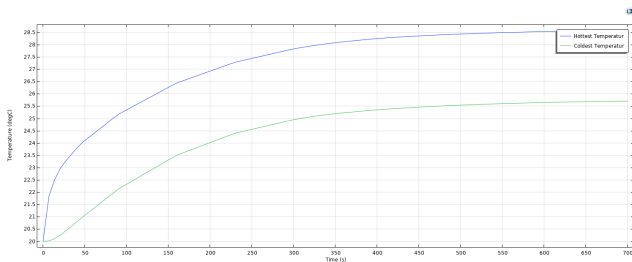


Abbildung 10: Änderung der Temperatur mit der Zeit

Die Simulation ist zeitabhängig für $t < 700s$. Für Zeiten $t > 700s$ ändert sich das Ergebnis nur noch minimal. Die statische Enttemperatur ist erreicht. Die Kurvenform ist die einer Differentialgleichung. $T(t) = K \cdot e^{\lambda t}$ mit $\lambda < 0$. Es ist ein stabiles System. Die eingepreiste Leistung ist gleich der abgegebenen Leistung. Wegen der Trägheit des Systems ist auf den schematischen Schaltplan in Abbildung 11 zu schließen. Das Einschwingverhalten von der grünen Bahn lässt auf in Reihe geschaltete PT_1 Glieder schließen.

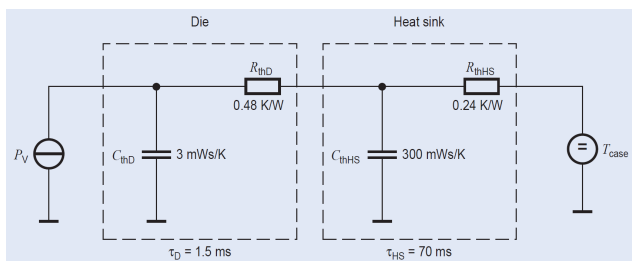


Abbildung 11: Ersatzschaltplan: Thermodynamisches Verhalten [8]

5 Fazit

Die Leiterbahn wurde nach Industriestandard ermittelt. Die Formeln, um das Problem händisch zu lösen über-

schätzen den tatsächlichen Wert.

Die Formeln enthalten eine Sicherheit.

Auch bezieht sich die Formel auf eine 4-Fach so große Fläche als simuliert wurde.

Die erste Formel schätzt den Wert gut und ist nur $\Delta T = 10,2K - 8,6K = 1,6K$ von der simulierten Lösung entfernt. Die LTSpice Simulation mit $\Delta T = 13K - 8,6K = 4,4K$ ist weiter entfernt.

Es wurde davon ausgegangen, dass der Wärmestrom der nicht direkt an die Umwelt abgegeben wird immer 1,5mm durch das Dielektrikum fließt. Die Annahme scheint nicht zu stimmen.

$\Theta_{*,Ambient}$ sind die dominierenden Faktoren in der Gleichung.

Bei verändern dieser Wertes wird die Spice Simulation genauer.

Comsol verwendet andere Werte für die thermische Leitfähigkeiten und müssen bei Bedarf an die echte Platine angepasst werden.

Die Bestimmung der Leiterbahnbreite nach Industriestandard kann ohne Probleme weiter empfohlen werden.

Literatur

- [1] Wuerth Elektronik eiSos [online], [Zugriff am 22.12.2021] Verfügbare unter: https://www.wuerthonline.com/web/en/index.php/show/media/04_leiterplatte/2011_2/relaunch/produkte-5/heatsink/neu_2011/TecReport012011EN-S.pdf
- [2] Prof. Dr. Reddig, Vorlesung Leistungselektronik
- [3] TDK-Lambda Germany GmbH [online], [Zugriff am 22.12.2021] Verfügbare unter: <https://www.emea.lambda.tdk.com/de/KB/Was-Sie-über-die-Lebensdauer-von-Stromversorgungen-wissen-sollten.pdf> Aachen, TDK-Lambda Germany GmbH
- [4] Texas Instruments, 01.04.2013, [Zugriff am 22.12.2021] Verfügbare unter: <https://www.ti.com/lit/pdf/snva419?keyMatch=THERMAL%20DESIGN%20BY%20INSIGHT%20NOT%20HINDSIGHT>
- [5] IPC [online], [Zugriff am 22.12.2021] Verfügbare unter <https://www.ipc.org/TOC/IPC-2221.pdf>, United States, IPC
- [6] Cree, Inc. Optimizing PCB Thermal Performance for Cree XLamp LEDs 22.12.2010, [Zugriff am 22.12.2021] Verfügbare unter <https://www.digikey.de/en/articles/optimizing-pcb-thermal-performance-for-cree-xlamp-leds>
- [7] Aisler B. V. [online], [Zugriff am 22.12.2021] Verfügbare unter <https://aisler.net/help/design-rules-and-specifications/specifications>
- [8] Infineon Technologies AG, 11.07.2000, [Zugriff am 22.12.2021] Verfügbare unter: <https://www.infineon.com/dgdl/smdpack.pdf?fileId=db3a304330f6860601311905ea1d4599>